



半導体実装業界マップ

2022年7月27日

大阪大学産業科学研究所フレキシブル 3D 実装協働研究所

1. 公開目的

半導体実装(*)に関するビジネス機会創出・拡大のため、F3D 実装コンソーシアム参加メンバー(企業や大学等)が有する情報を基に業界マップを作成し、世の中に情報発信する。 *パワー半導体、先端 AI・IoT 半導体の実装を対象とする

2. 作成

大阪大学産業科学研究所フレキシブル 3D 実装協働研究所(F3D 研究所)

F3D コンソーシアム

3. 内容

- (1)マップの種類
- ・製品化企業等一覧:製品化している企業名等の一覧
- ・製品等詳細:各企業・大学等の製品・技術名、カテゴリー、特徴・アピール点を掲載

(2)カテゴリー

実装構成部材を念頭に、以下の8項目にカテゴリー化

- ①ワイヤ ②ダイアタッチ材 ③モールド樹脂 ④基板・ベース (リードフレーム)
- ⑤放熱板・フィン ⑥製造装置・評価装置 ⑦信頼性評価・検査(計測評価含む)
- ⑧その他

今後、より分かりやすいい表記とすべくカテゴリー自体を見直す可能性有り

- 4. 業界マップの取扱いについて
- ・改編、改ざん、販売を禁止する
- ・問合せ先:

F3D 研究所 加藤豊 TEL: 06-6879-4295 e-mail: katoyu@sanken.osaka-u.ac.jp

- 5. 業界マップの見方
- (1)製品化企業等一覧
- ・サプライチェーンを考慮しながら実装構成部材をカテゴリー化、カテゴリーごとに該当企 業名等を掲載

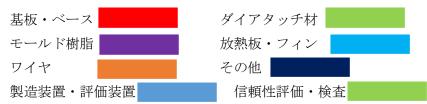
(2)製品等詳細





- ・カテゴリー化は製品化企業等一覧に同じ
- ・カテゴリーごとに色分けし、製品・技術の詳細を表記





・企業名を選択するとリンクが開き、製品やその技術情報等を見ることが出来る。

(製品情報先がない場合は、その企業等のホームページに移行する)

以上